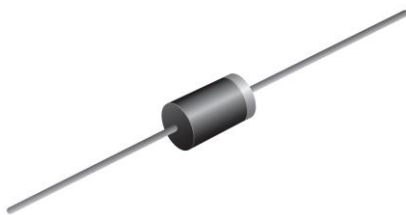


RP1HG高压快恢系列产品

01

产品简介

双晶叠焊DO-15轴式封装设计，反向重复峰值电压 V_{RM} **2000V**，反向恢复时间 T_{rr} Max **50ns**@ $I_F=100mA$ ， $I_{RP}=200mA$ ，75% recovery point， $T_j=25^\circ C$ 。



DO-15 (DO-204AC)

02

产品特点

- ❑ 外六角内圆钝化层芯片专利结构设计，有效避免产品应用过程中芯片边缘尖端放电；
- ❑ 芯片采用SIPOS+Glass+LTO三层钝化保护设计；
- ❑ V_{RM} **2000V**超高压， T_{rr} Max **50ns**@ $I_F=100mA/I_{RP}=200mA/75\% RP/T_j=25^\circ C$ ，满足高压高频应用线路；
- ❑ 双芯片叠焊封装设计；
- ❑ 最高工作结温 T_j 150°C；
- ❑ 塑封料符合UL94 V-0阻燃等级，满足安规需求。

03

电性参数

P/N	Package	I_F (AV) /A	V_F @ I_F/V	V_{RRM}/V	I_R/uA	I_{FSM}/A	T_{rr}/ns^*	$T_j/^\circ C$
RP1HG	DO-15	0.1	7.0	2000	2.0	5	50	-40~150

Remark: 详细参数请参考产品datasheet. *: @ $I_F=100mA$ ， $I_{RP}=200mA$ ，75% recovery point, $T_j=25^\circ C$

04

应用领域



太阳能光伏逆变器



高频高压开关电源



微波设备



高频机/热合机